

た か だ こ ら む

ネプコン ジャパン[秋]2023, SEMICON® Japan 2023 に出展

当社の半導体製造装置技術PRのため、2023年9月13日（水）～15日（金）に幕張メッセにて開催された「ネプコン ジャパン[秋]2023」および2023年12月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトにて開催された「SEMICON® Japan 2023」に出展しました。

各展示会における全体の来場者数は以下のとおりで、昨年と比較すると約1.5倍強となり、当社ブースにも多くの方が訪れ、大盛況となりました。

ネプコン ジャパン[秋]2023 : 25,161人（2022年：16,247人）

SEMICON®Japan 2023 : 85,282人（2022年：51,480人）

1. ネプコン ジャパン[秋]2023

ネプコン ジャパン[秋]2023 は今回で2回目の開催となる電子機器・半導体の電子部品・材料、製造・検査装置メーカーが一堂に出展するエレクトロニクス開発・実装展です。本展は、市場が益々拡大しているパワーデバイス&モジュールに特に力をいれており、専門出展エリアを設けているため、ターゲット顧客と効率的にマッチングすることができる販路拡大の絶好の場となりました。

その中で当社は、パワーデバイスを主なターゲットとして超音波カッティング装置「CSX501」の実機を展示し、切断事例として最新デバイス解析などを中心にPRを行い、新たな顧客獲得を目指しました。

【展示内容】

(1) 実機展示とパネル展示

- ・超音波カッティング装置（CSX501, CSX-100Lab）の実機展示
- ・超音波アシスト切断の原理や効果などをアニメーション動画にて紹介
- ・ダイシング装置としてSiC, AlNなどの切断実績を紹介
- ・超音波カッティング装置による断面観察作業の効率化のPRや切断事例の紹介
- ・枚葉式ウェット処理装置（TWPシリーズ）とアプリケーション事例の紹介

(2) その他展示品

- ・スマートフォンなどに使用される電子部品や車載用電子部品の断面切断サンプル
- ・装置生産能力のPRを目的として大口径化が進む8インチSiCのサンプル

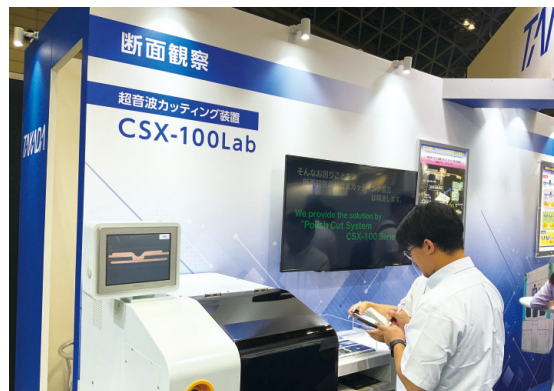


図1 当社ブースの様子

2. SEMICON® Japan 2023

SEMICON® Japan 2023は今回で47回目の開催となる世界最大級のエレクトロニクス製造サプライチェーン総合展示会です。本展は、DX時代を支える先端技術のコアとしての半導体を主軸に、半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、自動車やIoT機器、医療機器などの応用分野まで、国内でも類を見ない幅広いトピックをカバーするイベントとして展開されており、幅広い顧客層に当社の装置事業をPRする絶好の場となりました。

その中で当社は、パワーデバイス、MEMS、光デバイス、SAWデバイス等を主なターゲットとして枚葉式ウェット処理装置（TWPシリーズ）のPRを行い、新たな顧客獲得を目指しました。

【展示内容】

(1) パネル展示

- ・枚葉式ウェット処理装置（TWPシリーズ）とアプリケーション事例の紹介
- ・超音波アシスト切断の原理や効果などをアニメーション動画にて紹介
- ・ダイシング装置としてSiC、AlNなどの切断実績を紹介
- ・超音波カッティング装置による断面観察作業の効率化のPRや切断事例の紹介

(2) その他展示品

- ・スマートフォンなどに使用される電子部品や車載用電子部品の断面切断サンプル
- ・装置生産能力のPRを目的として大口径化が進む8インチSiCのサンプル

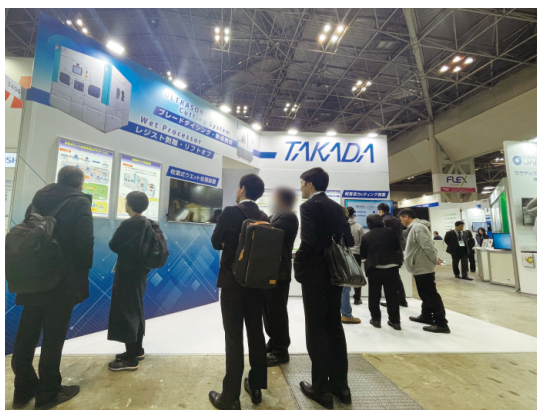


図2 当社ブースの様子

3. まとめ

今回の各展示会では、多くの方に当社の装置や技術に関心を持っていただき、また、例年に比べ海外からの来場者も増加し、国内外問わず幅広い顧客層に当社の装置事業をPRすることで、装置メーカーとしての認知度向上を図ることができました。

今後も装置メーカーとして定着できるように技術力、販売力を強化して事業拡大を目指していきたいと考えております。

阿部 拓哉（装置事業部）

※SEMICONは米国セミの商標です。